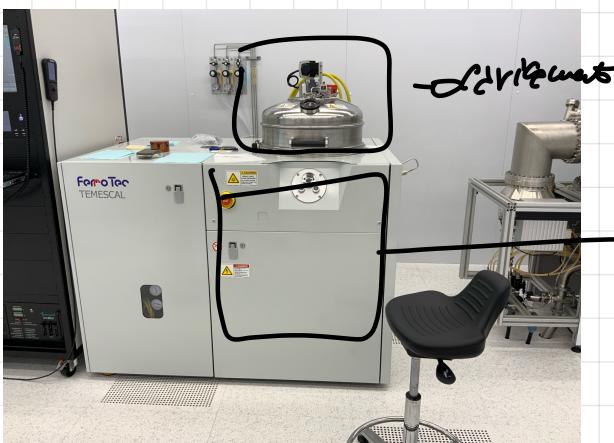


End P Ortothe can and cont ék'



6.8



Carburetta un po' con

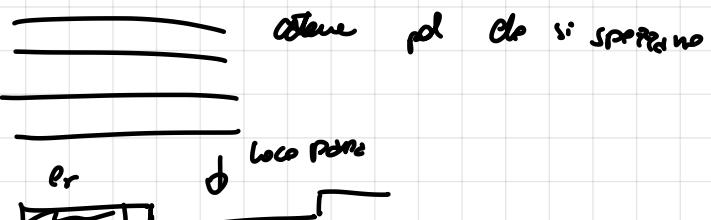
Vusto

I fili si collegano e risparmiano. Un vusto abbina il posto di uscita

Questi hanno un generatore elettronico. Gli e- sono conosciuti sul supraduro a 120° offerto dalle scaldature del campanile elettronico (nel gabinetto).

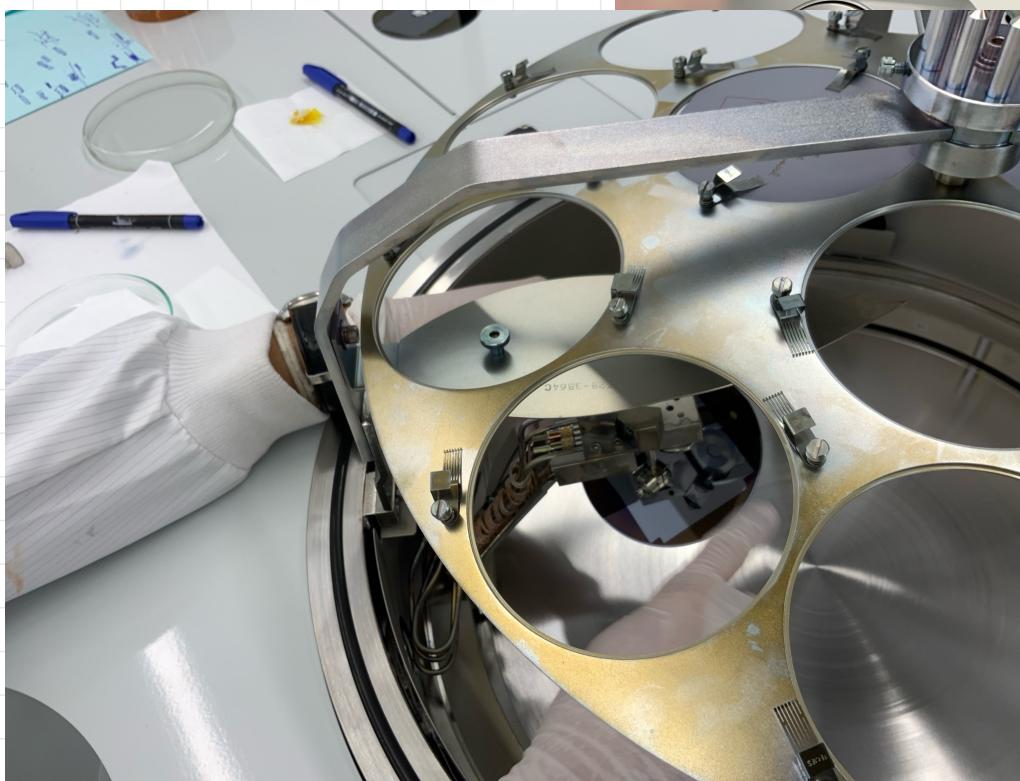
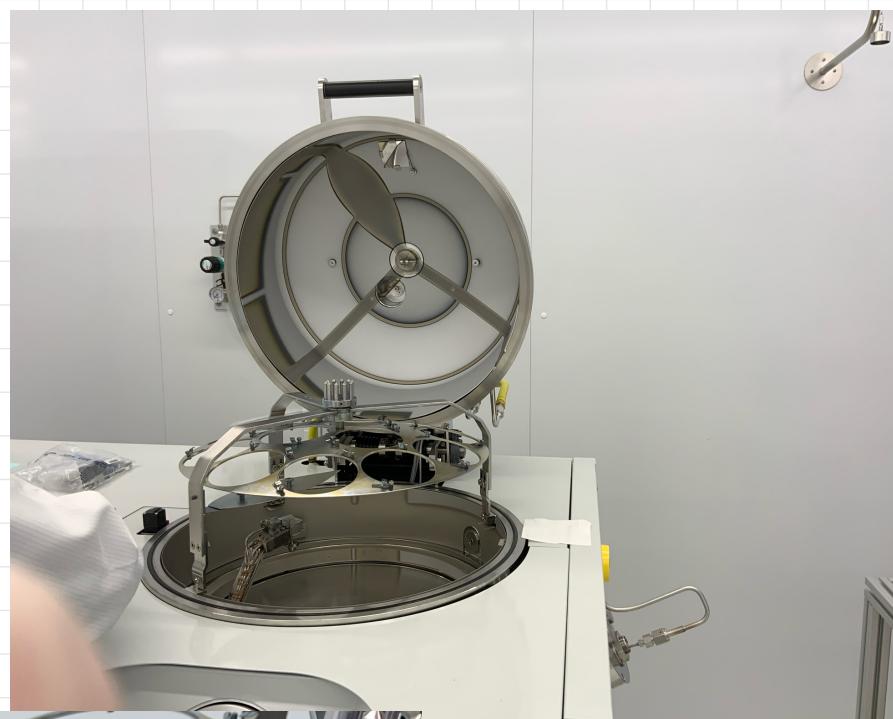
Problema: l'attacco al vusto in questo e' fuori posto b. la linea deve dar una c'è' il br. Se v+o-o-0 viene o via via.

AZ 5214 -0 varietà: Si + da -. la differenza e' la massa e la q.



In cui due punti estremi si spaziano e lo sviluppo lo stesso. Questo e' +





Uso dove molto più piacevole non si avvicinare perché ha tempo i leggeri
scendere e i leggeri si rimettessi in modo continuo

però lo perde

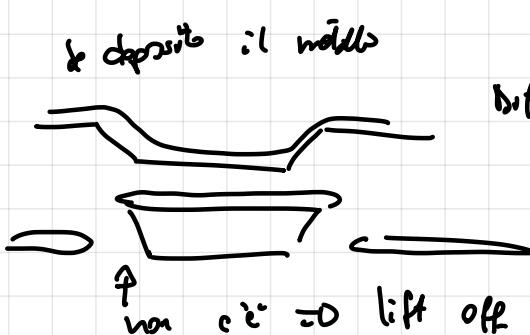
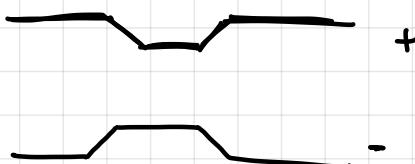
gradi angolo



Questo è preferibile in modo -
o meglio detto.

Quando però questo c'è insabbiabile e non si trova più quando lo avvicina più.

Ci sono due profili fatti così:



dipendenza da fondo

Uso per con molte rappe → fotografie fai tu AL perché faccio le cose male).

Altre cose vuole fatto con lift off

Dopo due ore il modello lo inserisco e lo vediamo al SER. Quando usciamo ha
troppo effetto

Ora chiediamo le foto. Visto PC → facendo la valvola è molto N

(C) ogni scatto è grande.
ogni che tutto sicuramente

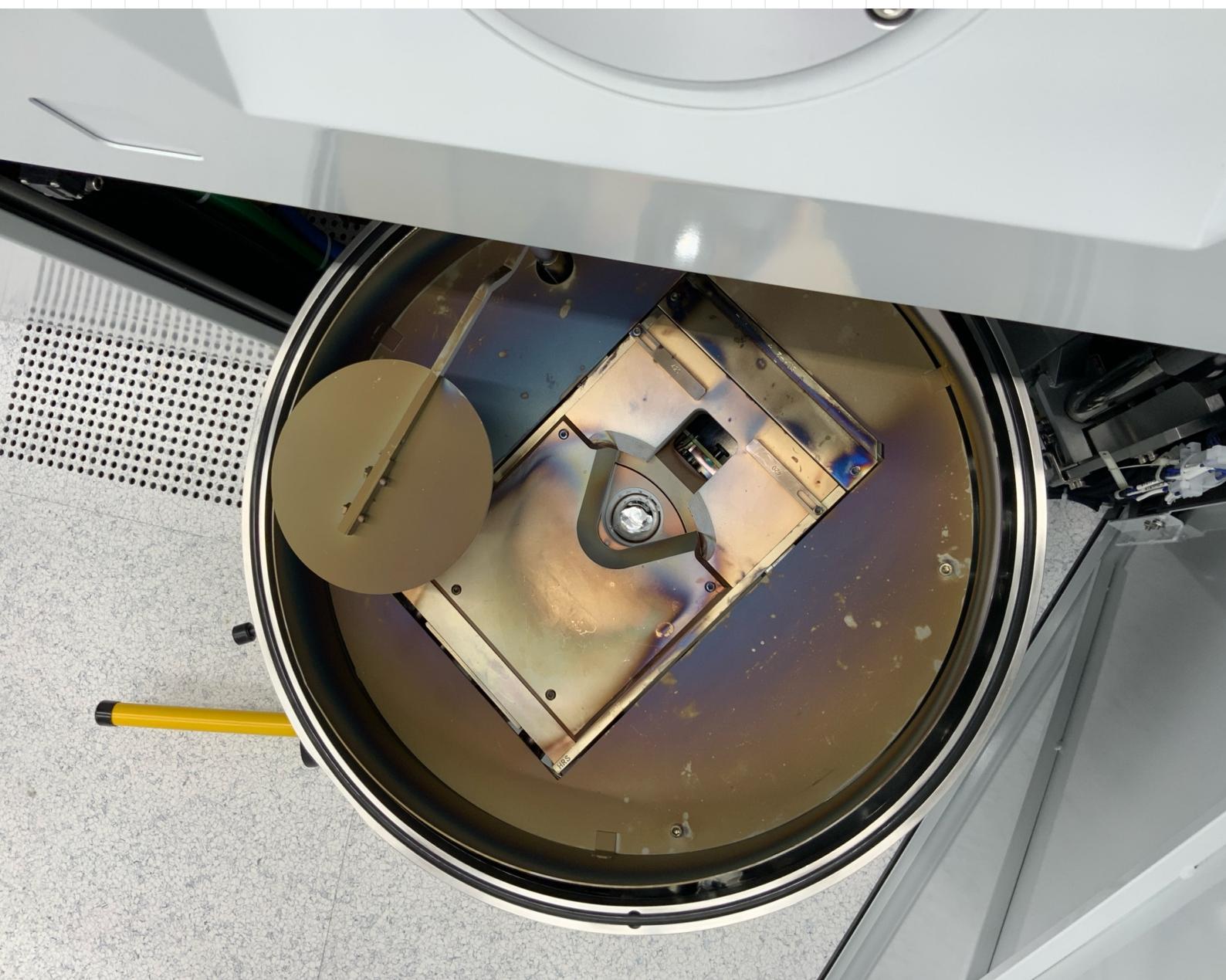
profilo utile dei

Autor zu h, war f die Vakuumzelle gewünscht oder ist es i wertig gewählt? → Vakuumzelle

Pump.

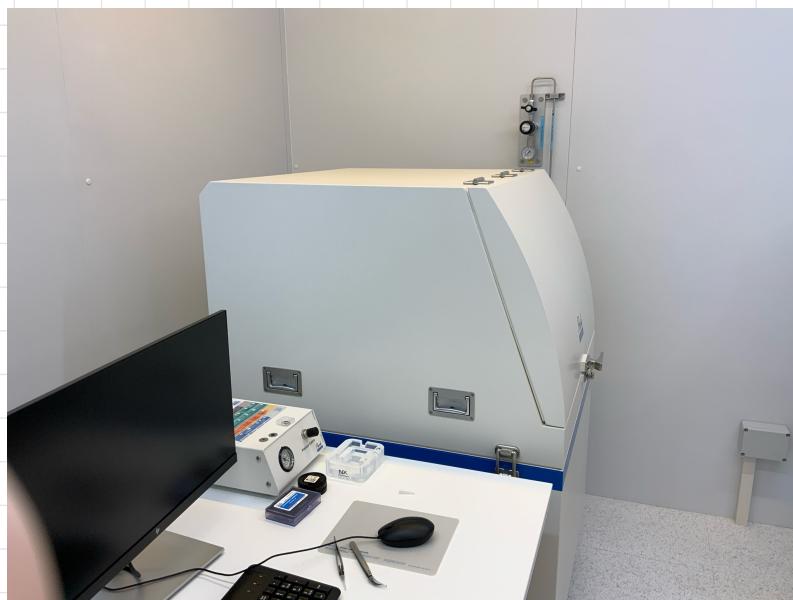
Syphon und -> der zu Ende

Rivapumpen -> ab 10^{-2} < 10^{-6} in sec. tempo



Abito nello studio

Pi taglierà il vestito uomo interno



ATM.

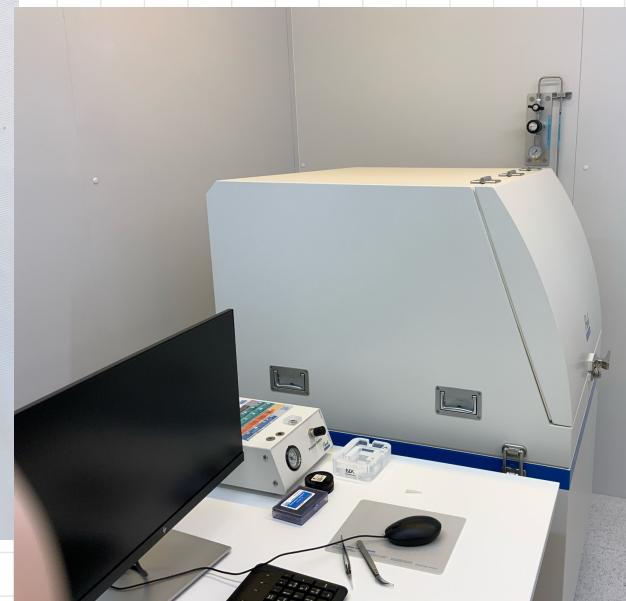
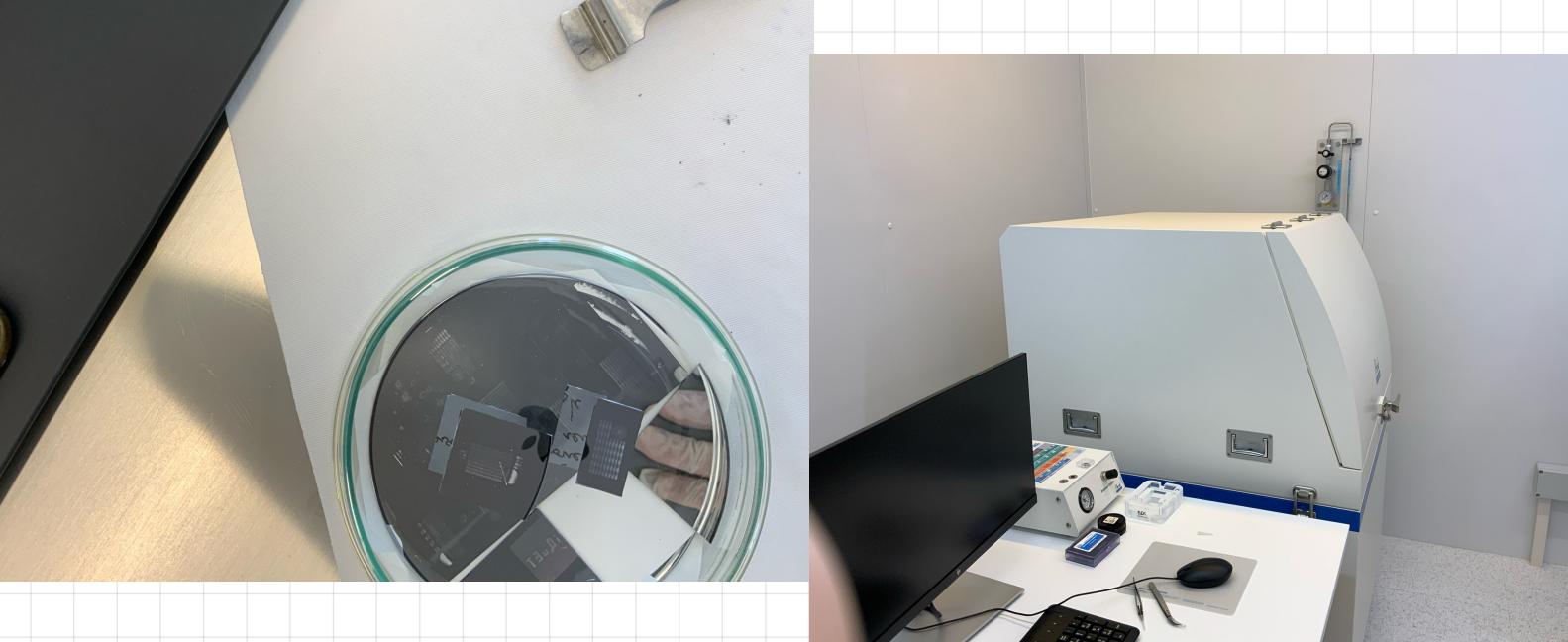
Gomma e cuoio per luci i riflettori sul film

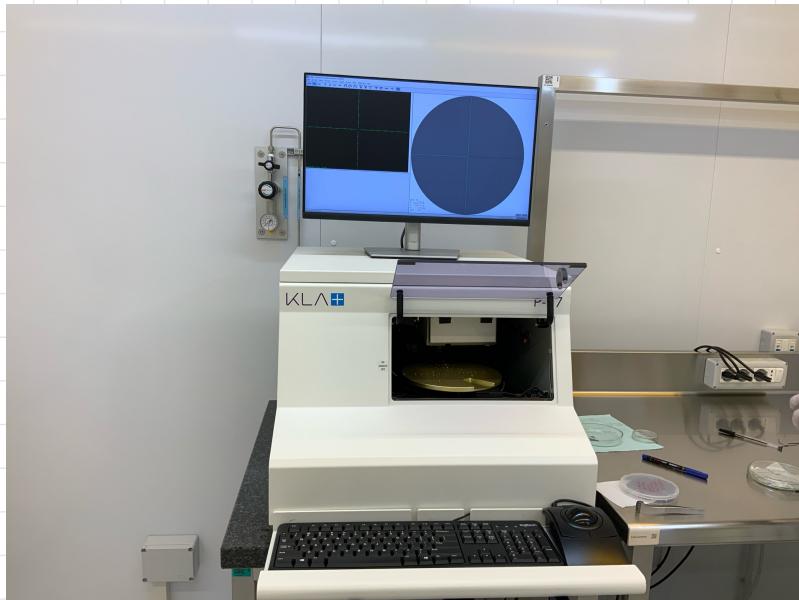
ellissandro.



Prof. laureato.



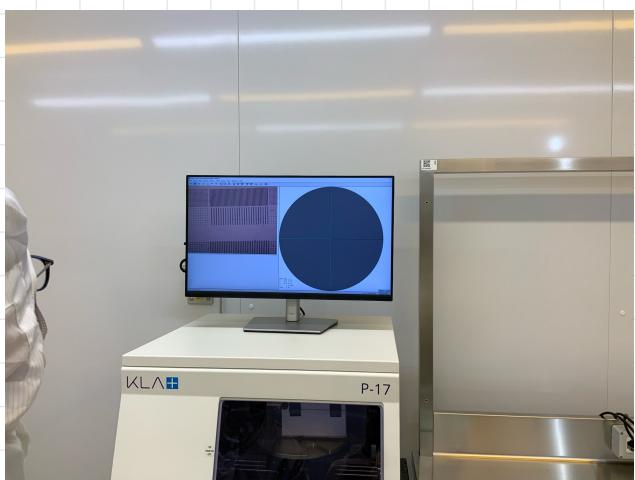




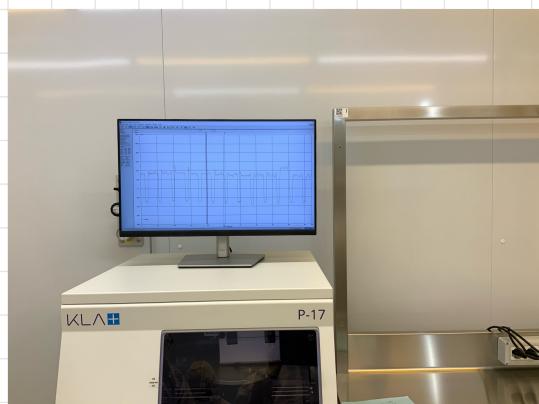
profilometro

Potrebbe il sottile in mp720.

Prima non dà focus.



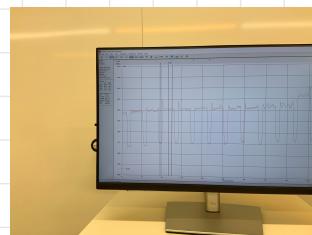
trova con più e less la posizione del catturatore.



Profilo un po' minore, ma Attr.

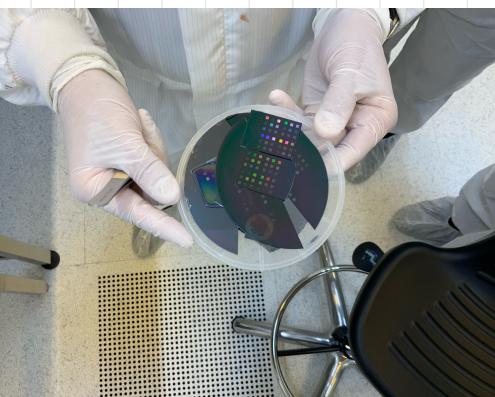
Più alta At, però hanno Sì.

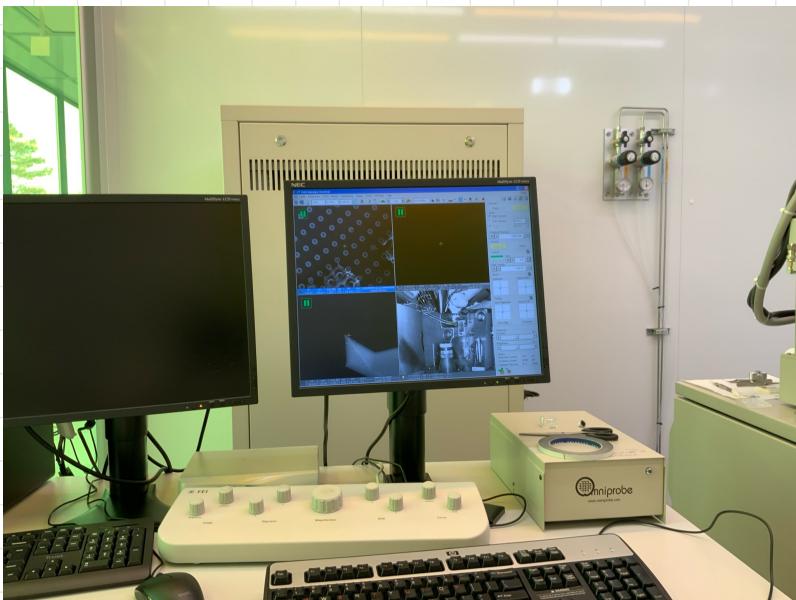
L'altezza è 626 Å



Bisognerebbe scoprire se la riuscita' è regolare.

Di finitissime Sì.





Dad Brown spieva la ditta da Google
perché era buttato Go -> basta T fissa le
cuciture perché ci sia.

E' un modo super preciso per saper tutto
(dove dovrebbe) cosa c'è lì (fatti mm).

Usavate TL per estare e la si solda
con del PC

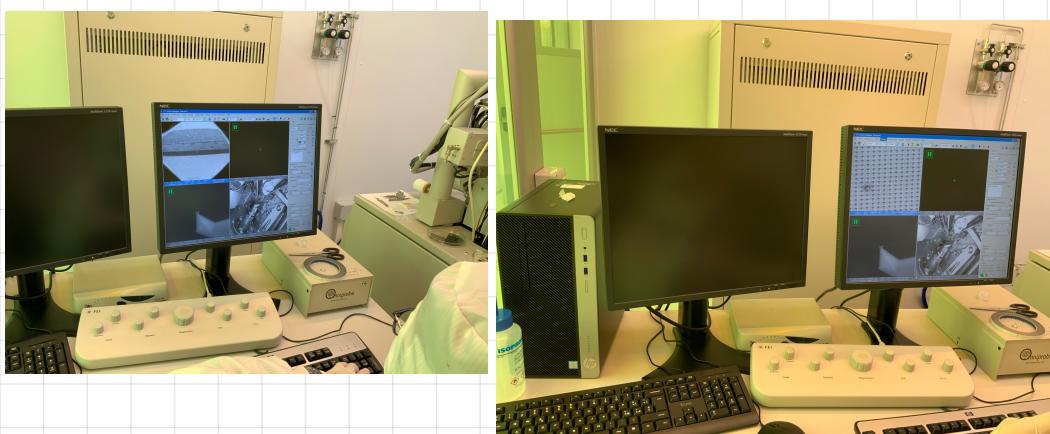


Ritirava su un supporto e in un istante poteva toccare con lo stilettino una 60°-70°

Ora si parla di 10^{-6} (unità Empirical 5 10^{-6} mBar).

Noi è rendevano di $7-8 \cdot 10^{-5}$ mbar. Vediamo il photodiode. (Questo è il 60 secondo passo dove il lift si va a mettere non c'è stato fatto).

Inizio a $9 \cdot 10^{-5}$ mbar.



Io dico delle girelle e del ph.

Sai subito che abbiamo fatto: non possiamo!



Al così T e si sente il taut.

Piller, 20 kV: e⁻ entro molto. E' difficile vedere il Re di 50 nm.



5 kV: risoluzione peggiora ma si vede il contrasto.



a) Risoluzione peggiora ma le parti belle c'è Al perché gli e⁻ rimbalzano (prova di un photodiode).



Aumento a 20 kV dà una più risoluzio (dove più picco) prob sono più piccoli (da Brugel).



Misuriamo lo spessore ma va corretto per che c'è filato!

Quindi gli diamo 60° di induttore.



Altro per me non c'è, si vedo bene il rendering.



Adam faendo uno screenshot.

GTO GRAFIA

Proprio Wafers e mettiamo la più Photoreist → quando si fer.

Azione ph. resist

Repartizione da cui prima

HMTS sono con spinner. Pensa quindi al work and to take H₂O e mettiamo H₂. Poi mettiamo il ph resist e lo escludono a 60°.
Lo soft bake per le componenti additi.

Si esponendo con gli UV.

Azione UV che posso usare che poi una volta dare image inverso di ciò vogliamo

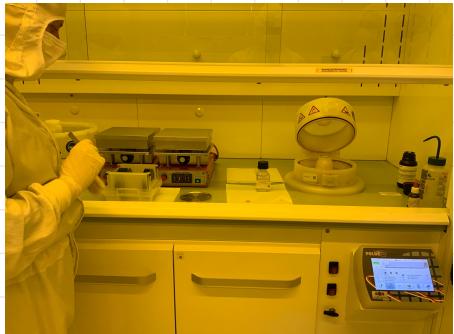
I Primer prende superficie di Si quindi sensibilità aumenta. Si ricorda meglio ph. resist.

HMTS

Uscita dell'attacco allo rimuovere il resist. Uscita un linea per poter later spargere lo spinner.

Arricchiamo la piastra e la portiamo a 120°

Wafers risciacqua polish (1,0,0) 1,500 µm spessore e grado-chiaro. Pieno di waffer



Dic che la piastra è avvicinata gradualmente alla piastra. Friction 1 min a 120°, poi riflettiamo il wafer e mettiamo il primer.

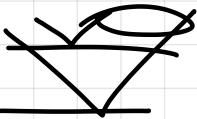
Lo seguiamo per doverlo l'H₂O.

Il wafer è fatto riflettere nell'acqua di Al e si sfrutta in fiamma.

Centriamo il wafer e lo facciamo sfioro fermo con uno pump da vuoto. Poi lo facciamo sputare. Siccome HMTS è un liquido lo vedremo subito in spinner.

Quando il layer è uniforme vedremo delle frange di interferenza.



 → int. I due raggi fanno interazione.

Ora i raggi fanno la piega a 110° , perciò il filo con cui che ha reazione va verso la HDPV e così.

Ora vogliamo il fotodrill. Prendiamo il vetro e lo poniamo nello spinner, tirando le punte e i fili vogliamo uno spray fino a 1000 rpm e lascia così.

E' importante usare for bora

WP put in AZ 400 K (su supporto) i 3 wafer per 41 s. di es., giri 23.

